

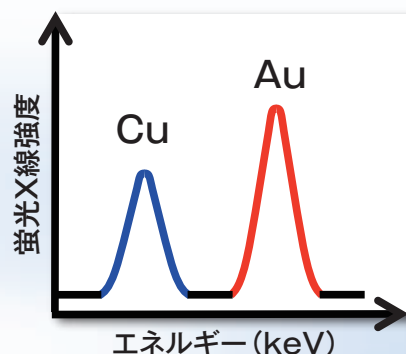
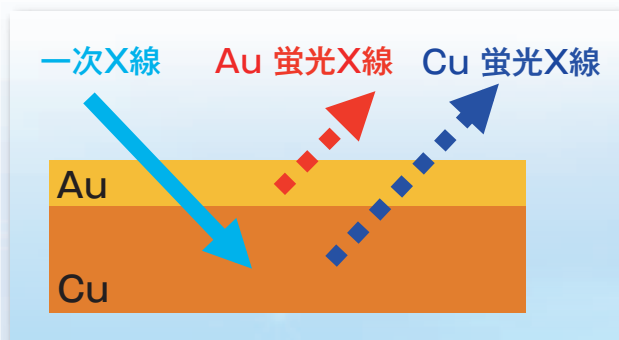
# 蛍光X線分析によるめっき膜厚測定の実理

## Principle of thickness measurement for plating by XRF

### ◎ 原理



蛍光X線装置を用いためっき膜厚の測定法は、試料にX線を照射し、めっき部から放射される蛍光X線量を測定して、めっきの厚さを求める方法です。



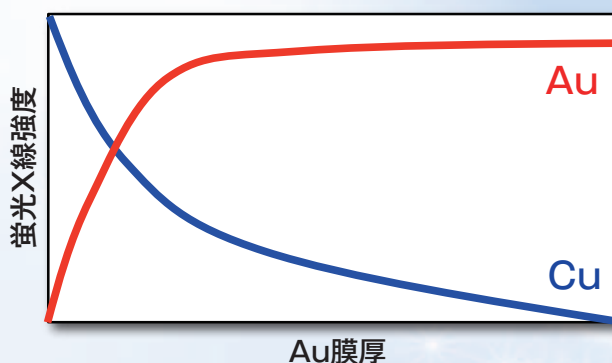
AuとCuの蛍光X線スペクトル

#### <めっき層>

膜が厚くなるとその  
蛍光X線強度は増加します。

#### <素材(下地)>

めっき層の膜が厚くなると  
素材の蛍光X強度は減少します。



### ◎ 特長

- 非破壊での測定が可能のため、製品検査にも活用できます。
- 多層膜を同時に測定することが可能です(各層が異なる元素に限る)。
- 複数点の測定が可能のため、製品面内のめっき厚みムラの評価が可能です。
- 膜厚は数nmから数十μmのレンジで膜厚を求めることが可能です(元素による)。

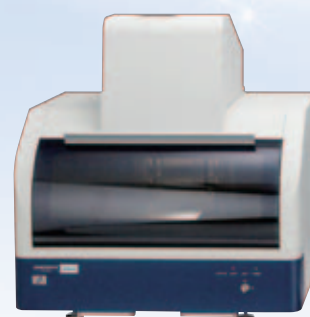
### ◎ 対象機種



FT110A



FT150(シリーズ)



EA6000VX